



FICHA TÉCNICA

BROPASTE ELECTRONIC - ECO 5

Pasta de soldadura SMD - ECO 5, libre de haluros, No-Clean. Para una amplia gama de aplicaciones y diseños de PCB, de acuerdo con la aleación 501 UNE-EN ISO 9453.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES		
Apariencia	Pasta gris sin cuerpos ni elementos visibles	
Composición Aleación	ECO 5 - Sn/Ag0.3/Cu0.7	JIS-Z-3282
Punto de fusión	217-227 °C	
Tamaño Partícula	(T 4) +38µm <1%, -20µm <10%	IPC-TM-650, 2.2.14
Forma de la partícula	Esférica	
Contenido de Flux	11.5 ± 1.0%	JIS-Z-3197, 8.1.2
Contenido de haluros	< 0.0 wt.% (en flux)	J-STD-004
Viscosidad	200 ± 30 Pa·s (25±1°C, 10 rpm, Malcom)	JIS-Z-3284 Annex 6
Tipo de Flux	ROLO	J-STD-004

PROPIEDADES ECO 5 (Aleación 501)

Elemento	Composición (ECO 5)
Estaño (Sn)	Rem.
Plata (Ag)	0.2-0.4
Cobre (Cu)	0,5-0,9
Antimonio (Sb)	0,10
Bismuto (Bi)	0,06
Oro (Au)	0,05
Plomo (Pb)	0,07
Indium (In)	0,10
Aluminio (Al)	0,001
Arsenico (As)	0,03
Cadmio (Cd)	0,002
Hierro (Fe)	0,02
Niquel (Ni)	0,01
Zinc (Zn)	0,001

Para obtener más **datos** técnicos de nuestros alloys por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Fecha de revisión: 26/02/2020

FICHA TÉCNICA

BROPASTE ELECTRONIC - ECO 5

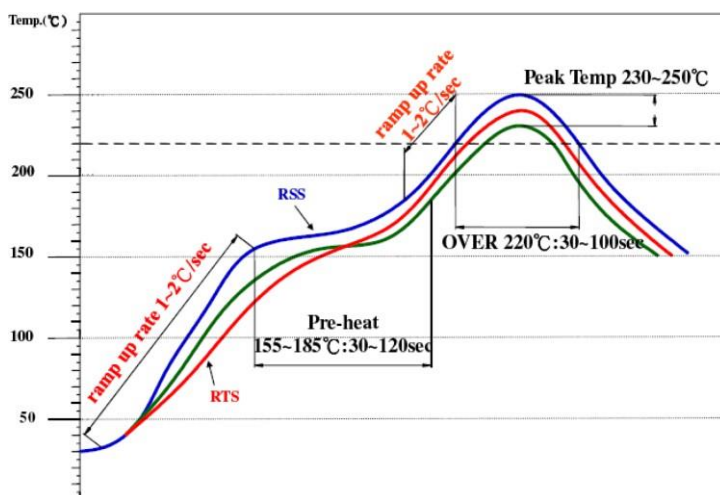
RENDIMIENTO Y FIABILIDAD

TESTS DE		
Corrosión de la placa de cobre	Pass	JIS-Z-3197, 8.4.1
Difusión	>70%	JIS-Z-3197, 8.3.1.1
Cromatografía iónica	0.0 wt.%	IPC-TM-650 Method 2.3.28.1
espejo de cobre	Pass	IPC-TM-650, 2.3.32
Viscosidad (25°C, 10 rpm)	200 ± 30 Pa·s	JIS-Z-3284, Annex 6
Pegajosidad (gf)	>130 (8hr.)	JIS-Z-3284, Annex 9
Asentamiento o caída	Pass	JIS-Z-3284, Annex 7, 8
Bola de soldadura	Pass	JIS-Z-3284, Annex 11
S.I.R * Resistencia de aislamiento	> 1x10 ⁹ Ω, Pass	IPC-TM-650, 2.6.3.3
Migración eléctrica **	Pass	IPC-TM-650, 2.6.14.1

*Condiciones test : 85°C RH durante 168 hrs.

**Condiciones test: 65°C, 88.5% RH durante 596 hrs.

PERFIL DE REFLUJO RECOMENDADO



- Tasa de Aceleración (Ramp Up rate): (30-150°C) 1.0-2.0°C/seg
- Tiempo de Pre-Calentamiento (Pre-heating Time): (155-185°C): 30-120 seg.
- Periodo de tiempo por encima de (Time period above of) : 220 °C: 30-100 Seg.
- Aumento durante el Reflujo (Ramp Up During Reflow) : 1.0-2.0°C/seg.
- Punta Máxima Temperatura (peak Temp) 240-250°C
- Rampa Temperatura Descenso (Ramp Down Rate): 1.0-6.0°C/seg.

Fecha de revisión: 26/02/2020



FICHA TÉCNICA

BROPASTE ELECTRONIC - ECO 5

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Refrigerar la pasta de soldadura de 0-10°C. La vida útil es de 6 meses a partir de la fecha de producción.
- Mantenga alejado de la luz solar directa.
- Permita que la pasta alcance la temperatura de impresión definida (temperatura ambiente) durante 3-4 horas. No caliente la pasta de soldadura rápidamente.
- Para el embalaje en tarro, mezcle la pasta de soldadura antes de usarla durante 1-3 minutos con espátula de plástico.
- Se recomienda terminar la pasta fresca dentro de las 24 horas. No mezclar pasta usada y la pasta fresca nueva en el mismo frasco.
- Si el proceso de impresión se interrumpió durante más de una hora, retire la pasta restante de la plantilla y cerrar el frasco.
- Temperatura de entorno de impresión recomendada. 22-28°C y HR 30-60%

FORMATOS

<i>Aleación Soldadura (501)</i>	<i>Flux</i>	<i>Tamaño Partícula</i>	<i>Envase</i>
ECO 5(SnAg0.3Cu0.7)	ROLO	T4 – 20-38 µm	50 g. Jeringa 500 g. Tarro

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios técnicos y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la gran variedad de materiales y condiciones de trabajo en las que se utilizan nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o los daños causados por mal uso.

Fecha de revisión: 26/02/2020